

公司代码：688689

公司简称：银河微电

常州银河世纪微电子股份有限公司

2020 年年度报告摘要



一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

详情敬请参阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“（二）风险因素”相关内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以分红方案实施时股权登记日登记的为基数，向登记在册全体股东每10股派现金红利人民币2.5元（含税），截至2021年3月31日，公司的总股本为12,840万股，预计支出分红资金3,210.00万元，占2020年度归属于母公司股东净利润的46.16%。2020年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

该利润分配预案已获得公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

☒适用 ☐不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	银河微电	688689	不适用

公司存托凭证简况

☐适用 ☒不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	金银龙	徐涛
办公地址	常州市新北区长江北路19号	常州市新北区长江北路19号

电话	0519-68859335	0519-68859335
电子信箱	gmesec@gmesemi.cn	gmesec@gmesemi.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是一家专注于半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业，致力于成为半导体分立器件细分领域的专业供应商及电子器件封测行业的优质制造商。公司以客户应用需求为导向，以封装测试专业技术为基础，积极拓展二极管芯片制造技术，初步具备 IDM 模式下的一体化经营能力，可以为客户提供适用性强、可靠性高的系列产品及技术解决方案，满足客户一站式采购的需求。

2、主要产品或服务情况

公司主营各类小信号器件（小信号二极管、小信号三极管）、功率器件（功率二极管、功率三极管、桥式整流器），同时还生产车用 LED 灯珠、光电耦合器等光电器件和少量三端稳压电路、线性恒流 IC 等其他电子器件。公司产品广泛应用于计算机及周边设备、家用电器、适配器及电源、网络通信、汽车电子、工业控制等领域，并可以为客户进行封测定制加工。

(二) 主要经营模式

公司坚持以客户需求为导向，依托技术研发和品质管控能力，积极实施包括多门类系列化器件设计、部分品种芯片制造、多工艺平台封测生产以及销售服务的一体化整合（IDM），采用规模生产与柔性定制相结合的生产组织方式，以自主品牌产品直销为主满足客户的需求，从而实现盈利。

1、采购模式

公司采用“集中管理、分散采购”的模式，将供应链管理的规范性和适应产销需求的采购快捷灵活性有效地结合起来，并通过计划订单拉动和安全库存管控相结合的方式，达到兼顾快速交付订单和有效管控存货风险的要求。

2、生产模式

公司采用“以销定产，柔性组织”的生产模式。公司依据专业工艺构建产品事业部组织生产，以实现产能的规模效应和专业化管理。同时，公司以市场为导向，努力构造并不断优化适应客户需求的多品种、多批次、定制化、快捷交付的柔性化生产组织模式。

3、营销模式

公司依托自主品牌和长期积累的客户资源，采用“直销为主、一站式配套”的营销模式。公司建有较强的营销团队和集客户要求识别、产品设计、应用服务、失效分析等为一体的技术服务团队，依托丰富的产品种类和专业化的技术支持，为客户提供一站式采购服务。

4、研发模式

公司采用“自主研发、持续改善”的研发模式。公司技术研发中心统一组织管理新产品研发以及技术储备研发活动，涵盖需求识别、产品设计、新材料导入、芯片制造和封测、模拟试验和验证、应用服务等各个技术环节，构建相互支撑、持续改善的系统性创新体系。

公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化，未来还将继续保持。公司将以技术创新为基础，积极整合各类资源，充分满足下游产业和客户对产品的需求，促进公司业务的持续健康发展。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业的发展阶段

公司主要从事半导体分立器件的研发、生产和销售，属于新一代信息技术领域的半导体行业。半导体行业位于电子行业的中游，是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。半导体产品按结构和功能可进一步细分为分立器件和集成电路，分立器件与集成电路共同构成半导体产业两大分支。近年来，分立器件占全球半导体市场规模的比例基本稳定维持在 18%-20% 之间。

与海外半导体产业进入成熟阶段不同，我国半导体处在奋起追赶的发展黄金窗口期，产业发展任重道远。近年来，我国分立器件企业紧跟国际先进技术发展，通过持续的技术创新不断推动产品升级，在技术研发和先进装备方面进行了大量的投资，并积极向中高端市场渗透，与国际厂商展开竞争，已经在消费电子等细分应用领域取得了一定的竞争优势。

(2) 行业的基本特点

半导体行业需要持续的高投入，具有资金密集、技术密集的特点，导致明显的头部集中格局。以英飞凌、安森美、意法半导体为代表的国际领先企业占据了全球半导体分立器件的主要市场份额，2018 年度前十大分立器件公司均为国外企业，前十大半导体分立器件企业市场占有率合计达到 63.50%，市场集中度较高。

半导体行业是研发最密集的行业，国际领先企业掌握着中高端芯片制造技术和先进的封装技术，其研发投入强度高于国内企业，全球排名前三的半导体分立器件企业英飞凌、安森美及意法半导体在 2019 年度的研发费用分别占到营业收入的 11.77%、11.61% 及 15.72%，高于国内同行业可比公司，在全球竞争中保持优势地位。

半导体行业下游需求领域广泛，景气周期与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。我国已经成为全球制造业第一大国和全球最大电子产品消费市场，根据 WSTS 的数据显示，2019 年度我国半导体市场销售额占到全球的 35%，而且仍在不断上升。根据中国半导体行业协会的数据显示，2013 年-2019 年我国半导体分立器件产业销售收入由 1,536 亿元增长至 2,772 亿元，年复合增长率为 10.34%，保持较高的增长速度。

半导体分立器件技术研发的重点是提高效率、增加性能和减少体积，不断发展新的器件理论和结构，促进各种新型分立器件的发明和应用。未来技术发展将会呈现以下几个特点：

① 新型功率半导体分立器件将不断出现，替代原有市场应用的同时，还将开拓出新的应用领域。如美国 Gree 公司研发出用于移动 WiMAX 用途的新的功率 GaN RF 功率晶体管，在 40v、3.3GHz 下峰值脉冲输出功率达到创记录的 400W。

② 新材料、新技术不断得到发展和应用。为了使现有功率半导体分立器件能适应市场需求的快速变化，需要启用新技术，不断改进材料性能或研发新的应用材料，继续优化完善结构设计、制造工艺和封装技术等，提高器件的性能，如第三代半导体材料 SiC、GaN 等的应用。

③ 体积小、模块化、功能系统化趋势明显。电子信息产品的小型化、甚至微型化，必然要求其各部分零部件尽可能小型化、微型化、多功能。为适应整机装备效率和提高整机性能的可靠性、稳定性的需求，半导体分立器件将会趋向模块化、集成化。

(3) 行业的主要技术门槛

半导体分立器件的研发及生产过程涉及半导体物理、微电子、材料学、机械工程、电子信息等众多学科，需要综合掌握和应用器件设计、芯片制造、封装测试、应用试验等专业技术，属于技术密集型行业。随着下游应用场景不断更新和拓展，电子产品的升级频率更加快速，对半导体分立器件产品的性能参数、可靠性、稳定性等都有持续提升的要求，下游应用对供应商快速满足其新需求的配套设计能力和技术服务支持能力的需求也越来越高。因此，本行业对新进入者具有较高的技术壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

从全球市场来看，半导体分立器件市场集中度较高，且由于国外企业的技术领先优势，几乎垄断了汽车电子、工业控制、医疗设备等利润率较高的应用领域。因此，总体而言，国内半导体分立器件企业与国际领先企业在规

模及技术上都存在一定差距。

我国半导体分立器件市场呈现金字塔格局，第一梯队为国际大型半导体公司，凭借先进技术占据优势地位；第二梯队为国内少数具备 IDM 经营能力的领先企业，通过长期技术积累形成了一定的自主创新能力，在部分优势领域逐步实现进口替代；第三梯队是从事特定环节生产制造的企业，如某种芯片设计制造、或几种规格封装测试。

公司通过长期的行业深耕，在多门类系列化器件设计、部分品种芯片制造、多工艺封装测试等环节均掌握了一系列核心技术，具备较强的根据客户需求进行产品定制，并以多工艺制造平台制造生产来满足客户需求的能力，在国内属于具备一定技术优势的半导体分立器件厂商。

小信号器件是公司的核心优势产品，布局较早、具备先发优势，在国内市场的占有率超过 5%。是该领域的知名自主品牌。公司在功率器件领域具有一定的市场影响力，多次被评为“中国半导体功率器件十强企业”，属于国内半导体分立器件行业中规模较大的领先企业。

客户认证是半导体分立器件行业的核心门槛之一，公司在计算机及周边设备、家用电器、适配器及电源、网络通信、汽车电子、工业控制等领域得到了诸多知名龙头客户的长期认可，并随着公司技术水平的不断提升，产品逐步进入工业控制、安防设备、汽车电子、医疗器械等应用领域，具备较强的客户认证优势。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

虽然硅材料平台目前仍然是主流的半导体分立器件工艺平台，并将在未来相当一段时间内占据主要市场，但新的半导体材料，如 SiC、GaN 工艺平台正在逐步走向成熟，Diamond 材料也有很好的发展前景。公司针对 GaN、SiC 基半导体功率器件产品已有一些预研及技术储备，GSC 系列 650V/1200V SiC 肖特基产品也已小批量生产。在平面型、槽栅型 MOSFET 产品方面公司均有布局，而“采用 Clip 技术的功率 MOS 器件焊接技术”项目的实施，将进一步提升公司在 MOS 器件封装的功率密度和热性能方面的技术优势。

半导体分立器件的封测逐步向尺寸更小、功率密度更高的方向发展，芯片逐步向高性能、高可靠性发展。目前在公司自主生产的产品中，封装形式主要集中在前三代，第四代封装已经实现量产，第五代封装尚处于试样阶段，还未形成收入。由于各代封装固有的特性优势，预计在众多领域的需求还会持续共存。此外，公司从功率二极管芯片的工艺和结构两个方面着手，积极推进技术研发活动，以满足持续提升产品性能和可靠性的需求。

半导体分立器件产业链主要包含器件及芯片设计、芯片制造、封装测试三大工艺环节，根据所涉及经营环节的不同，经营模式分为纵向一体化（IDM）以及垂直分工两种。由于分立器件在投资规模方面采用 IDM 模式具备经济效益上的可行性，同时分立器件的产品设计和生产工艺都会对产品性能产生较大的影响，对器件设计与制造工艺的整合能力要求较高，因此业内领先企业一般都沿着逐步完善 IDM 环节的模式发展。公司以封装测试专业技术为基础，逐步拓展部分功率二极管芯片的设计和制造能力，已经初步具备了 IDM 模式下的一体化经营能力。

近年来，分立器件产品的国产化趋势日益明显，特别是“中兴事件”之后，半导体的进口替代被提升到国家战略层面。一方面国内厂商具备一定的效率和成本优势，并随着近年来国内半导体产业的发展，领先企业的产品结构不断升级，已经逐步具备了参与到中、高端市场竞争的能力。另一方面，为保证供应链的稳定性，之前主要依赖进口分立器件的诸多国内知名客户也纷纷转向寻找国内供应商。因此，借助于国家产业基金、金融和税收政策的支持，国内领先企业将成为进口替代和参与国际市场竞争的主力军。

报告期内，新冠肺炎疫情爆发下的“宅经济”加速了全球数字化转型，云服务、服务器、笔记本电脑、游戏和健康医疗的需求不断上升，5G、物联网、汽车、人工智能和机器学习等技术的快速发展，也一起推动了市场对半导体产品的需求。其次，新冠肺炎疫情冲击了全球供应链，加剧了供需矛盾。相对来说，我国更早复工复产，管控有效，使得国内企业能够获得更多的市场机会。根据中国半导体行业协会（CSIA）的预测，我国半导体分立器件市场需求将从 2019 年 2,784.2 亿元增长至 2022 年的 3,447.8 亿元，保持持续增长势头。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	809,105,481.52	699,439,280.72	15.68	655,551,177.39
营业收入	610,235,005.07	527,893,779.40	15.60	585,382,675.45
归属于上市公司股东的净利润	69,538,921.58	52,724,499.00	31.89	55,880,100.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,125,303.17	49,611,410.82	15.15	53,158,509.99
归属于上市公司股东的净资产	576,207,759.20	505,956,237.66	13.88	473,194,138.70
经营活动产生的现金流量净额	74,297,702.95	106,376,790.55	-30.16	64,146,531.23
基本每股收益（元/股）	0.72	0.56	28.57	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.56	28.57	0.58
加权平均净资产收益率（%）	12.85	11.02	增加1.83个百分点	12.56
研发投入占营业收入的比例（%）	5.79	6.10	减少0.31个百分点	5.90

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	105,287,192.12	158,076,446.99	166,947,893.50	179,923,472.46
归属于上市公司股东的净利润	8,056,532.80	22,648,175.39	18,898,762.19	19,935,451.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,712,804.56	17,522,664.97	15,816,496.92	17,073,336.72
经营活动产生的现金流量净额	9,170,673.34	22,626,617.82	12,635,208.55	29,865,203.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	6
------------------	---

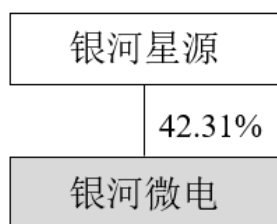
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					11,502			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0			
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0			
前十名股东持股情况								
股东名称 （全称）	报告 期 内 增 减	期 末 持 股 数 量	比 例 （ % ）	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	包 含 转 融 借 出 的 售 份 数 量	质 押 或 冻 结 情 况		股 东 性 质
						股 份 状 态	数 量	
常州银河星源投资有 限公司		40,747,740	42.31			无		境 内 非 国 有 法 人
恒星国际有限公司		34,473,000	35.80			无		境 外 法 人
常州银江投资管理中 心（有限合伙）		8,182,260	8.50			无		其他
常州银冠投资管理中 心（有限合伙）		5,508,000	5.72			无		其他
常州清源知本创业投 资合伙企业（有限合 伙）		4,500,000	4.67			无		其他
上海聚源聚芯集成电 路产业股权投资基金 中心（有限合伙）		2,889,000	3.00			无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				截至报告期末，银河星源持有公司 42.31%的股权，为公司的控股股东；杨森茂先生通过银河星源、恒星国际、银江投资与银冠投资间接控制公司 92.33%的股权，为公司的实际控制人。除此之外，公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用				

存托凭证持有人情况

☐适用 ☒不适用

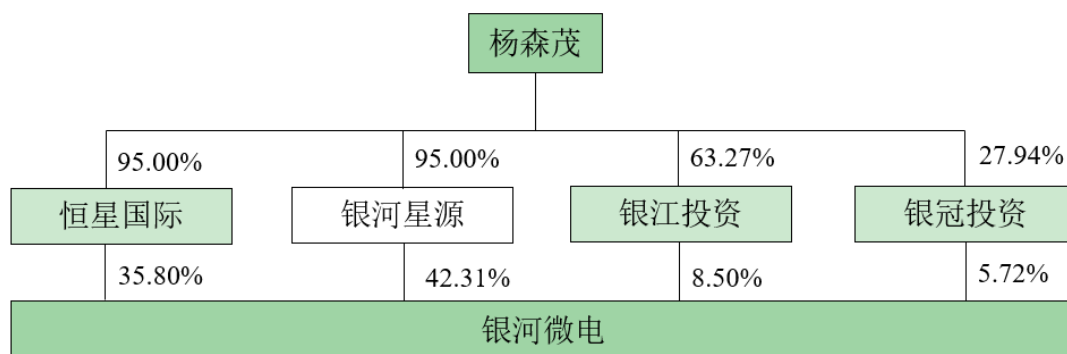
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年公司实现营业收入 61,023.50 万元，同比增加 15.60%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,953.89 万元，同比增加 31.89%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,712.53 万元，同比增加 15.15%。

2 面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，执行新收入准则对2020年资产负债表相关项目期初数的影响具体详见本报告第十一节（五）重要会计政策及会计估计之“44 重要会计政策和会计估计的变更”相关描述。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。无合并范围的变化。